

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-008

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐电话会议 ☒其他（“我是股东”走进沪市上市公司-芯海科技）
参加单位名称	东方证券相关人员及中小投资者共 21 人
日期/时间	2025 年 11 月 13 日 15:00-17:00
地点	深圳市南山区深圳湾创新科技中心三楼芯海科技会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：万巍先生 董事、财务总监：谭兰兰女士 董事会秘书：张娟苓女士
投资者关系活动主要内容介绍	11 月 13 日下午，在上交所指导下，公司联合东方证券组织开展“我是股东”投资者走进沪市上市公司—芯海科技活动。公司董事会秘书张娟苓女士就公司基本情况介绍，并与公司副总经理万巍先生、财务总监谭兰兰女士共同与投资者围绕以下问题进行交流。 一、公司 BMS 和 PPG 产品在头部客户实现规模出货，标志着业务取得了重要突破。请问公司未来将采取哪些具体策略，来进一步提升这些核心产品在现有头部客户中的份额，并加速向更多行业龙头客户进行渗透？特别是，如何利用‘芯片+算法+场景+AI’的全栈式解决方案这一独特模式来构建长期的竞争壁垒？ 公司回答：我们独特的“芯片+算法+场景+AI”全栈式解决方案模式，正是构建长期竞争壁垒的核心。在健康测量领域，我们通过 PPG 芯片结合 AI 算法，为用户提供完整

的健康管理服务；在计算领域，我们以 EC 芯片为核心，打造了涵盖 PD 快充、BMS 管理等产品的外围生态。这种模式让我们从单纯的芯片供应商，升级为能够提供系统级解决方案的合作伙伴，通过持续的技术迭代和场景深耕，不断增强客户粘性，构筑起坚实的技术护城河。

未来，我们将从两个维度持续发力：在深化现有合作方面，我们将通过定制化开发和快速响应机制，持续优化产品性能，特别是在笔记本电脑、智能穿戴等优势领域，进一步提升在现有头部客户中的采购份额。在拓展新客户方面，我们正积极推进车规级 BMS AFE 芯片的发布，加快进入汽车电子等高门槛市场。

二、应用于人形机器人的“电子皮肤”、“六维力传感器”等技术，当前处于探索阶段还是已有具体客户合作项目及量产时间表？

公司回答：在人形机器人领域，半导体的集成度、智能化和感知水平都需达到更高水平，机器人的感知、决策、执行等动作需要电子皮肤、六维力传感器、空心杯电机等设备作为基础桥梁，而这些设备的精确运转离不开对应的高精度 ADC、MCU、触觉反馈芯片、传感器调理芯片、压力触控芯片等硬件的支持。在这个领域，特别是在人形机器人的‘电子皮肤’和‘六维力传感器’等关键应用上，公司目前正处于与相关客户共同进行技术探索和合作开发的阶段，属于公司前瞻性业务布局。

三、车规级产品（如 BMS AFE、MCU）的 AEC-Q100 认证进展、在新能源汽车客户中的导入和上量情况如何？

公司回答：芯海已经有多款 MCU 和 ADC 产品成功通过了 AEC-Q100 认证，并且都已经在多个头部客户端实现量产。公司首款 ASIL-B 等级 BMS AFE 芯片也即将发布。首款高性能、高可靠性、高功能安全 ASIL-D, 等级的车规 MCU 已经流片，相关研发工作进展顺利，与头部客户以及 Tier1 厂家的定点合作正在有条不紊的展开。

四、有向 AMD 提供什么产品和服务吗？

公司回答：公司 EC 芯片今年进入 AMD Approved vendor list（认证供应商列表），这意味着笔记本生产厂商在 Intel 平台之外，还可在 AMD 平台上选择使用芯海科技的 EC 芯片。但我们并不会给 AMD 直接提供产品。

五、在竞争激烈的市场中，公司如何保持竞争优势？

公司回答：芯海科技致力于集成电路技术及应用领域的持续创新，旨在帮助客户创造高价值产品，推动其商业成功。随着 AI 技术从云端向边缘设备、终端设备延伸，具

备 AI 能力的终端设备正迎来爆发式增长，万物感知、万物智能、万物互联的实现需要信号链的感知和连接能力，这恰好是芯海的优势，公司于 2017 年推出 AIoT 整体解决方案，以“感知+控制+云平台+连接”一站式解决方案，赋能物联网产业，使得不同智能终端设备、不同系统平台、不同应用场景之间能够实现互融互通。

（1）ADC+MCU 全信号链芯片设计基石能力

在芯片层，公司以高精度 ADC 与高可靠 MCU 为核心，为消费、工业、汽车等领域提供硬件基石：ADC 能将模拟信号转为数字信号。公司 ADC 产品特点包括高精度（24 位无失码，42nV 最小可测）、高线性度（最大误差 $\leq 10\text{ppm}$ ）、温差影响小（增益温漂 $< 3\text{ppm}$ ，内置温度传感器），适合多场景；MCU 整合多种组件，可实现多样化控制。公司 2008 年开发自主 MCU 内核，推出相关 SoC 芯片，2010 年推出首颗通用 MCU。

（2）“芯片+解决方案”的整合服务能力

在解决方案层，基于 ADC+MCU 技术底座并结合公司对多元应用场景的理解，公司整合芯片与解决方案，推出 EC、BMS、PD 等系统解决方案，通过软硬件协同设计，帮助客户缩短开发周期，降低综合成本，并依据客户需求不断创新，快速开发出满足客户需求且具有竞争力的产品。

（3）“芯片+解决方案+云端 app”能力驱动 AI 落地

公司于 2017 年推出 AIoT 整体解决方案，以“感知+控制+云平台+连接”一站式解决方案，赋能物联网产业，使得不同智能终端设备、不同系统平台、不同应用场景之间能够实现互融互通。为 AI 技术在“云、边、端”的落地奠定基础：云端支撑健康管理等场景的数据挖掘与 AI 模型构建；边缘端满足企业数据隐私保护、低时延响应等需求；终端侧通过智能化硬件承载 AI 应用。公司持续助力各行业数字化转型，推动 AI 技术从云端向边缘设备、终端设备全面延伸。

芯海正从“芯片供应商”进化为“垂直行业智能化底座”以生态护城河应对同质化竞争，开启规模化增长。

六、公司采用什么样的研发模式？

公司回答：公司的研发模式始终坚持以客户需求为源头导向，新项目的立项主要源自对头部客户前瞻性需求的深度洞察。我们依托成熟的端到端研发体系，从市场调研、产品定义到芯片设计、系统验证直至量产交付，实现全流程闭环管理。这种以客户场景为中心的开发模式，确保了我们的 高精度 ADC、BMS 芯片、EC 控制器等产品能够精准解

	决客户痛点，快速在计算机、汽车电子等高端领域实现产业化应用。通过将客户需求与“模拟+MCU”双平台技术能力深度融合，我们正持续推动从芯片供应商向“芯片+算法+系统”整体解决方案提供商的转型升级。
附件清单 (如有)	/